

C19 层间对位公差按 $\pm 0.125\text{mm}$

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
工艺流程指示															
CAM指示	1	单元板尺寸和孔表见附件													
	2	贴片间距不足7mil, 无需保证阻焊桥													
	3	开窗与孔径等大的, 加大开窗, 保证开窗单边比钻孔大3mil制作													
	4	不允许字符上开窗焊盘													
	5	阻焊开窗按极限能力加大													
	6	拼板见附件, 邮票孔按我司常规削铜, 不允许露铜制作													
	7	标记加在to层, 周期格式YYWW													
	8	单元板内不允许额外铺铜, 工艺边按部分客户要求铺铜													
	9	无特殊要求时, NPTH孔公差按 $\pm 0.05\text{mm}$; PTH孔孔径小于等于1.1mm, 公差按 $\pm 0.08\text{mm}$, 孔径大于1.1mm, 公差按 $\pm 0.1\text{mm}$													
	10														
工序指示	1	符合ROHS标准													
	2	层间对位公差按 $\pm 0.125\text{mm}$													
	3	阻焊验收标准: IPC-SM-840 Class H													
	4	外层完成铜厚35um													
	5	表面焊盘最大平整度0.08mm													
	6	孔位公差按 $\pm 0.08\text{mm}$													
	7	蚀刻公差: 线宽间距小于0.3mm, 公差按 $\pm 20\%$; 线宽间距在大于等于0.3mm且小于0.8mm, 公差按 $\pm 0.05\text{mm}$; 线宽间距大于0.8mm, 公差按 $\pm 0.05/-0.1\text{mm}$													
	8	无特殊要求时, 最大内角圆角半径1.5mm													
不可批量制作的难点项目	1														
	2														